导热填隙料TIM-GAP Series

Thermally Conductive Silicone Gap Fillers

TIM-Gap系列是为满足为了满足工业发展对界面材料的高导热率，电绝缘性及可塑性的应用要求而设计。电隔离性能可用于需要在散热器和高压，裸铅设备之间的绝缘应用。在硅基和非硅基产品中可以达到热导率16 W / m°K的产品。

典型应用 Typical Applications

TIM-Gap填隙料用于填充部件或PC板与散热器、金属外壳和底架之间的缝隙。适用于由于阶梯、粗糙表面和高堆叠而存在较大的间隙情况。间隙填充材料让使用者更放心靠近散热器或散热片的部件散热问题。

TIMTRONICS THERMAL INTERFACE MATERIALS	1113	1115	1128	1161	HTC-13	HTC-16	NS
类型 Type	硅基 Silicone	硅基 Silicone	硅基 Silicone	硅基 Silicone	硅基 Silicone	硅基 Silicone	非硅基 Silicone Free
颜色 Color	粉红色 Pink	灰色 Gray	灰色 Gray	灰色 Gray	灰色 Gray	灰色 Gray	灰色 Gray
比重 @25°C Specific Gravity	2.0	2.1	2.5	3.22	3.3	3.2	2.1
硬度 (Shore 00) Hardness	24	25	50	45	75	72	53
可燃性等级 Flammability	UL 94 V-0	UL 94 V-0	UL 94 V-0	UL 94 V-0	UL 94 V-0	UL 94 V-0	UL 94 V-0
可操作温度范围 Operating Temp Range	-40℃ to 150℃	-40℃ to 150℃	-40℃ to 150℃	-40℃ to 150℃	-40℃ to 150℃	-40℃ to 150℃	-40℃ to 150℃
导热系数 (W/m-K) Thermal Conductivity	1.3	1.7	2.8	6.1	13.2	16	1.6
受力热阻(℃-in²/W) Thermal Resistance (1 mm Thickness)	15psi 0.93 40psi 0.71 70psi 0.60	15psi 0.90 40psi 0.80 70psi 0.70	15psi 0.55 40psi 0.44 70psi 0.40	15psi 0.37 50psi 0.31 70psi 0.28	14psi 0.16 50psi 0.15 70psi 0.14	14psi 0.13 50psi 0.12 70psi 0.11	14psi 1.02 50psi 0.78 70psi 0.61
击穿电压(KV /mm) Breakdown Voltage	16	13	14	14	12	10	11
介电常数(1KHz) Dielectric Constant	N/A	4.2	6.0	8.1	8.6	4.5	7.2
损耗因数(1KHz) Dissipation Factor	N/A	0.04	0.03	0.02	0.04	0.05	0.04
体积电阻率(Ohm-cm) Volume Resistivity	1.2×10^{12}	1.1×10^{12}	1.2×10^{12}	1.5×10^{11}	1.0×10^{14}	1.0×10^{11}	1.0×10^{12}
供应厚度(mm) Available Thickness	0.5 to 5.0	0.5 to 5.0	0.5 to 5.0	0.5 to 5.0	0.5 to 3.0	0.3 to 3.0	0.5 to 3.0
供应面积 Availability	300mm×200mm	300mm×200mm	300mm×200mm	300mm×200mm	300mm×200mm	300mm×200mm	300mm×200mm